DELL Technologies

Hoja de especificaciones



Diseño especial

- El líder en infraestructura de IA, como se indica en Forrester AI Infrastructure Wave
- Capacidad de consolidación 7:1*
- Hasta un 73 % de aumento en la eficiencia energética*

Inteligencia

- Ahorros de hasta US$ 50 000 gracias a la optimización de la administración y de la energía*[1]
- El 80 % de los servidores PowerEdge logran la designación EPEAT Climate+*[1]
- Hasta 150 minutos menos de tiempo de administración por cada 100 servidores*[1]
- Administración inteligente líder en la industria
  - Controladora integrada iDRAC 10 y
  - OpenManage Enterprise

Resiliencia cibernética

- Ofrece hasta **3,5 veces** más características de seguridad que la competencia*[1]
- Capacidad de adopción de **confianza cero**
- Garantía de fábrica a sitio con verificación segura de componentes

Sustentabilidad

- **Diseño para la eficiencia** Los servidores PowerEdge han reducido su intensidad energética (EI) un 83 % en los últimos 8 años
- **Eficiencia** Hasta un 73 % de aumento en la eficiencia energética

PowerEdge serie R

En la actualidad, los centros de datos se enfrentan a las demandas emergentes de la IA, lo que requiere soluciones escalables, eficientes y de alto rendimiento para manejar las exigencias de cargas de trabajo estándar y aceleradas. En este panorama, los servidores en rack Dell PowerEdge se destacan como una opción principal para profesionales de TI y administradores de centros de datos que buscan transformar sus infraestructuras.

Servidores Dell PowerEdge serie R: una selección integral de servidores en rack diseñados para satisfacer las rigurosas exigencias de la infraestructura de centro de datos moderna y escalable.



Rendimiento y versatilidad

Experimente la combinación perfecta de rendimiento, versatilidad y eficiencia energética con nuestros diseños de servidores avanzados, listos para el futuro y estándares de la industria. Diseñados para optimizar las operaciones, estos servidores reducen los costos operativos y admiten una escalabilidad sin inconvenientes, lo que permite que su empresa se adapte rápidamente a nuevas exigencias. Con la optimización de las cargas de trabajo, puede reducir el espacio físico del centro de datos y alinearse con los objetivos de sustentabilidad, todo sin sacrificar el rendimiento de primer nivel. Diseñados para cubrir las necesidades de entornos de alta demanda, estos servidores ofrecen funciones avanzadas, como opciones de configuración flexibles y expandibles, soluciones SmartCooling y herramientas de administración inteligentes.

Estos servidores, ideales para cargas de trabajo complejas, implementaciones de alta disponibilidad, tareas de IA y aplicaciones de inferencia, ofrecen una base confiable y flexible para gestionar los cambiantes requisitos comerciales. Sus confiables funcionalidades admiten una administración eficaz y la continuidad operacional.



- Arquitectura de GPU y procesadores avanzados
- Configuraciones de memoria expansivas
- Funcionalidades de I/O de alto ancho de banda
- Diseñado para enfrentar todas las cargas de trabajo, ya sean tradicionales o de uso intensivo de IA
- Configuraciones de I/O flexibles, con opciones frontales o posteriores
- Diseño estándar de sistemas de hardware modulares para centros de datos (DC-MHS)

Arquitectura con resiliencia cibernética para operaciones y entorno de TI de confianza cero

La seguridad está integrada en todas las fases del ciclo de vida útil de PowerEdge, lo cual incluye una cadena de suministro protegida y la garantía de integridad de fábrica al sitio. La raíz de la confianza basada en silicio afianza la resiliencia de arranque integral, mientras que la autenticación de múltiples factores (MFA) y los controles de acceso basado en funciones garantizan operaciones de confianza.

Más información

Aumente la productividad con las soluciones de administración de sistemas de Dell

Simplifique la administración de la infraestructura con iDRAC para la administración segura y remota de servidores, OpenManage Enterprise para optimizar la administración del ciclo de vida y AIOps habilitadas para IA para optimizar la infraestructura y las aplicaciones. Automatice las tareas, reciba alertas en tiempo real y escale sin esfuerzo para aumentar la productividad, el rendimiento y el tiempo de actividad.

Seguridad

Integrada en cada fase del ciclo de vida



Soluciones de enfriamiento y alimentación de Dell

Aborde los crecientes desafíos del centro de datos causados por la IA y las cargas de trabajo de computación densa mediante una gama de soluciones que mejoran las estrategias de enfriamiento del centro de datos, optimizan el rendimiento del sistema y facultan a las organizaciones para equilibrar la eficiencia, el rendimiento y la sustentabilidad.

Asistencia de expertos de Dell Technologies Services

Optimice el rendimiento en cada paso del camino con servicios que van desde una implementación rápida y sin inconvenientes con ProDeploy Infrastructure Suite, con configuraciones específicas de IA, hasta soporte proactivo y continuo con ProSupport Plus. Además, nuestros servicios de consultoría y administración aportan aún más valor al ofrecer estrategias personalizadas diseñadas para optimizar las operaciones, mejorar la eficiencia y ayudarlo a alcanzar sus objetivos comerciales únicos con confianza. Obtenga más información en Dell.com/Services o comuníquese con un representante de Dell hoy mismo.

Descanse tranquilo con Dell Technologies Services

ProSupport Plus for Infrastructure

- Mantenga sus servidores en funcionamiento con asistencia proactiva y predictiva.
- Benefíciese de un defensor del cliente asignado centrado en los resultados que espera, todo de forma ininterrumpida.
- Sepa que cuenta con la colaboración de otros fabricantes y asesoría para resolver problemas de gravedad 1.

Para su tranquilidad, recuerde que podrá optimizar aún más sus servidores con la consultoría de expertos, la implementación y los servicios administrados, entre otros, de Dell Technologies Services.

Productos Dell que funcionan mejor juntos

Potencie el fabric IP de próxima generación con redes abiertas 100/400 GbE de segunda generación. El modelo PowerSwitch S5448F-ON cuenta con 48 puertos SFP56-DD de 100 GbE y 8 puertos QSFP56-DD de 400 GbE, lo que ofrece una amplia gama de funcionalidades para satisfacer las crecientes demandas de los entornos de centro de datos actuales. Dell PowerVault: PowerVault proporciona soluciones SAN/DAS que permiten simplificar la expansión de capacidad de los servidores PowerEdge.

Productos Dell que funcionan mejor juntos



Potencie el fabric IP de próxima generación con redes abiertas 100/400 GbE de segunda generación. El Dell PowerSwitch Z9432F-ON ofrece 32 puertos de 400 GbE en un único switch.



PowerSwitch S5448F-ON cuenta con 48 puertos SFP56-DD de 100 GbE y 8 puertos QSFP56-DD de 400 GbE, lo que brinda una amplia gama de funcionalidades para satisfacer las crecientes demandas del entorno de centro de datos actual.

Dell PowerVault: PowerVault proporciona soluciones SAN/DAS que simplifican la expansión de la capacidad de los servidores PowerEdge

En este documento, se proporciona una lista completa de las características del producto. Sin embargo, es posible que las características marcadas con un asterisco (*) no estén disponibles en el lanzamiento, pero pueden venir incluidas en futuras actualizaciones. Tenga en cuenta que en este documento no se confirma la disponibilidad ni el cronograma de lanzamiento de ninguna característica. Para obtener información más precisa y actualizada sobre la disponibilidad de las características, consulte la página del configurador del producto en dell.com.

Característica	R470	R570	R670	R770	R6715	R7715	R6725	R7725	R7725xd	R770AP	R4715	R5715
Sistemas												
Procesador	• Un procesador Intel Xeon 6 E-core con hasta 144 núcleos • Un procesador Intel Xeon 6 de núcleo P con hasta 86 núcleos con opción de R1S	• Un procesador Intel Xeon 6 E-core con hasta 144 núcleos • Un procesador Intel Xeon 6 de núcleo P con hasta 86 núcleos con opción de R1S	Dos procesadores Intel Xeon 6, con hasta 144 núcleos u 86 núcleos P por procesador	Dos procesadores Intel Xeon 6, con hasta 144 núcleos u 86 núcleos P por procesador	Un procesador AMD EPYC serie 9005 de 5.ª generación con hasta 160 núcleos por procesador	Un procesador AMD EPYC serie 9005 de 5.ª generación con hasta 160 núcleos por procesador	Dos procesadores AMD EPYC Serie 9005 de 5.ª generación con hasta 192 núcleos por procesador	Dos procesadores AMD EPYC Serie 9005 de 5.ª generación con hasta 192 núcleos por procesador	Dos procesadores AMD EPYC Serie 9005 de 5.ª generación con hasta 192 núcleos por procesador	Dos procesadores Intel Xeon 6 serie 6900 con núcleos P con hasta 128 núcleos.	Un procesador AMD EPYC Serie 9005 de 5.ª generación con hasta 32 núcleos por procesador.	Un procesador AMD EPYC Serie 9005 de 5.ª generación con hasta 32 núcleos por procesador.
Memoria	• 16 ranuras DIMM DDR5, se admite RDIMM de 4 TB como máx., velocidades de hasta 6400 MT/s • Procesador Intel Xeon 6 de núcleo E, admite 1 TB como máximo • Procesador Intel Xeon 6 de núcleo P con hasta 86 núcleos y opción de R1S, admite 4 TB como máximo • Compatible solo con DIMM DDR5 ECC registrados Nota: El procesador instalado puede reducir la velocidad de funcionamiento del DIMM	• 16 ranuras DIMM DDR5 con una velocidad de hasta 6400 MT/s • Un procesador Intel Xeon 6 de núcleo E: admite RDIMM de 1 TB como máximo • Un procesador Intel Xeon 6 de núcleo P con hasta 86 núcleos con opción de R1S, admite RDIMM de 4 TB como máximo • Solo admite DIMM DDR5 ECC registrados. Solo admite DIMM DDR5 ECC registrados.	• 32 ranuras DIMM DDR5, se admite RDIMM de 8 TB como máx., velocidades de hasta 6400 MT/s • Compatible solo con DIMM DDR5 ECC registrados	• 32 ranuras DIMM DDR5, se admite RDIMM de 8 TB como máx., velocidades de hasta 6400 MT/s • Compatible solo con DIMM DDR5 ECC registrados	• 24 ranuras DIMM DDR5, se admite RDIMM de 6 TB como máx., velocidades de hasta 5200 MT/s • Compatible solo con DIMM DDR5 ECC registrados	• 24 ranuras DIMM DDR5, se admite RDIMM de 6 TB como máx., velocidades de hasta 5200 MT/s • Compatible solo con DIMM DDR5 ECC registrados	• 24 ranuras DIMM DDR5, se admite RDIMM de 6 TB como máx., velocidades de hasta 6400 MT/s • Compatible solo con DIMM DDR5 ECC registrados	• 24 ranuras DIMM DDR5, se admite RDIMM de 6 TB como máx., velocidades de hasta 6400 MT/s • Compatible solo con DIMM DDR5 ECC registrados	• 24 ranuras DIMM DDR5, se admite RDIMM de 3 TB como máx., velocidades de hasta 6400 MT/s • Compatible solo con DIMM DDR5 ECC registrados	• 24 ranuras DIMM DDR5, se admite RDIMM de 3 TB como máx., velocidades de hasta 6400 MT/s • Compatible solo con DIMM DDR5 ECC registrados	• 24 ranuras DIMM DDR5, compatibles con RDIMM, hasta 64 GB por DIMM, capacidad de memoria máxima de 1,5 TB, con velocidades de hasta 5200 MT/s. • Compatible solo con DIMM DDR5 ECC registrados.	• 24 ranuras DIMM DDR5, compatibles con RDIMM, hasta 64 GB por DIMM, capacidad de memoria máxima de 1,5 TB, con velocidades de hasta 5200 MT/s. • Compatible solo con DIMM DDR5 ECC registrados.
Controladoras de almacenamiento	• Controladoras internas (RAID): PERC H365i DC-MHS, PERC H965i DC-MHS frontal, adaptador PERC H365i, adaptador PERC H965i • Controladoras externas: HBA465e, H965e (RAID) • Arranque interno: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS): HWRAID 1, 2 SSD NVMe M.2, intercaladora M.2 con hasta 2 SSD NVMe M.2 o USB	• Controladoras internas (RAID): PERC H365i DC-MHS, PERC H965i DC-MH, adaptador PERC H365i, adaptador PERC H965i • Arranque interno: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS): intercalador M.2 con hasta 2 SSD NVMe M.2, USB • Controladoras externas: PERC H965e, HBA 465e	• Arranque interno: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS): HWRAID 1, 2 SSD NVMe M.2 o placa intercaladora M.2 (DC-MHS): 2 SSD NVMe M.2 o USB • Controladoras internas: PERC H965i frontal, PERC H975i frontal, PERC H365i frontal	• Arranque interno: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS): HWRAID 1, 2 SSD NVMe M.2 o placa intercaladora M.2 (DC-MHS): 2 SSD NVMe M.2 o USB • Controladoras internas: PERC H965i frontal, PERC H975i frontal, PERC H365i frontal	• Controladoras internas (RAID): PERC H365i, H965i, H975i • Arranque interno: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS) • HBA externos (no RAID): HBA465e	• Controladoras internas (RAID): PERC H365i, H965i, H975i • Arranque interno: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS) • HBA externos (no RAID): HBA465e	• Controladoras internas (RAID): PERC H365i, H965i, H975i • Arranque interno: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS) • HBA externos (no RAID): HBA465e	• Controladoras internas (RAID): PERC H365i, H965i, H975i • Arranque interno: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS) • HBA externos (no RAID): HBA465e	• Controladoras internas (RAID): N/A • Arranque interno: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS) • HBA externos (no RAID): N/D	• Arranque interno: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS): HWRAID 1: 2 SSD M.2 NVMe o USB • Controladoras internas: PERC H975i, DC-MHS frontal	• Controladoras internas (RAID): PERC H365i, H965i • Arranque interno: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS) • HBA externos (no RAID): N/D	• Controladoras internas (RAID): PERC H365i, H965i • Arranque interno: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS) • HBA externos (no RAID): N/D

Característica	R470	R570	R670	R770	R6715	R7715	R6725	R7725	R7725xd	R770AP	R4715	R5715
Compartimientos para unidades	Bahías frontales: • Hasta 8 EDSFF E3.S NVMe de 5.ª generación con un máximo de 491,52 TB • Hasta 16 EDSFF E3.S NVMe de 5.ª generación con un máximo de 983,04 TB • Hasta 8 unidades SATA/ NVMe de 2,5 pulgadas con un máximo de 491,52 TB • Hasta 10 unidades SATA/ NVMe de 2,5 pulgadas (con 4 universales de 2,5 pulgadas) con un máximo de 614,4 TB • Hasta 4 unidades SATA de 3,5 pulgadas con un máximo de 128 TB* (solo compatible con 2 unidades E3.S posteriores. No es compatible con la configuración de solo frontal independiente) Bahías posteriores: • Hasta 2 EDSFF E3.S NVMe de 5.ª generación con un máximo de 122,88 TB	Bahías frontales: • Hasta 12 unidades SATA (HDD) RAID de 3,5 pulgadas con un máximo de 384 TB* • Hasta 8 RAID NVMe de 2,5 pulgadas, con un máximo de 491,52 TB • Hasta 8 unidades NVMe de 2,5 pulgadas con un máximo de 491,52 TB • Hasta 8 unidades de 2,5 pulgadas SATA con un máximo de 30,72 TB • Hasta 8 unidades de 2,5 pulgadas SATA/universal con un máximo de 491,52 TB • Hasta 16 unidades SATA RAID de 2,5 pulgadas con un máximo de 61,44 TB • Hasta 24 unidades de 2,5 pulgadas SATA con un máximo de 92,16 TB • Hasta 8 EDSFF E3.S (pasillo caliente) NVMe de 5.ª generación con un máximo de 491,52 TB • Hasta 8 EDSFF E3.S (pasillo frío) NVMe de 5.ª generación, con un máximo de 491,52 TB • Hasta 16 unidades EDSFF E3.S (pasillo frío) NVMe de 5.ª generación con un máximo de 983,04 TB • Hasta 16 EDSFF E3.S (pasillo caliente) NVMe de 5.ª generación con un máximo de 983,04 TB • Hasta 32 EDSFF E3.S (pasillo caliente) NVMe de 5.ª generación con un máximo de 1966,08 TB Bahías posteriores: • Hasta 4 EDSFF E3.S NVMe de 5.ª generación con un máximo de 245,76 TB	• Sin configuración de backplane • Hasta 8 EDSFF E3.S NVMe con un máximo de 491,52 TB también con configuración de FIO • Hasta 16 EDSFF E3.S NVMe de 5.ª generación con un máximo de 983,04 TB • Hasta 20 EDSFF E3.S NVMe de 5.ª generación con un máximo de 1228,8 TB • Hasta 8 unidades SATA/ NVMe directas/Raid NVMe de 2,5 pulgadas con un máximo de 491,52 TB • Hasta 8 unidades universales de 2,5 pulgadas de 491,52 TB • Hasta 10 unidades SATA de 2,5 pulgadas con un máximo de 38,4 TB Bahías posteriores: • Hasta 2 EDSFF E3.S NVMe de 5.ª generación en la parte posterior con un máximo de 122,88 TB	• Sin configuración de backplane • Hasta 8 EDSFF E3.S NVMe de 5.ª generación con un máximo de 491,52 TB también con configuración de FIO • Hasta 16 EDSFF E3.S NVMe de 5.ª generación con un máximo de 983,04 TB también con configuración de FIO • Hasta 32 EDSFF E3.S NVMe de 5.ª generación con un máximo de 1966,08 TB • Hasta 8 unidades SATA/ NVMe de 2,5 pulgadas con un máximo de 491,52 TB • Hasta 8 unidades universales de 2,5 pulgadas con un máximo de 491,52 TB • Hasta 16 unidades SATA de 2,5 pulgadas con un máximo de 61,44 TB • Hasta 24 unidades SATA de 2,5 pulgadas con un máximo de 92,16 TB • Hasta 16 unidades SATA de 2,5 pulgadas y 8 unidades NVME de 2,5 pulgadas con un máximo de 552,96 TB • Hasta 40 EDSFF E3.S NVMe de 5.ª generación con un máximo de 2457,6 TB Bahías posteriores: • Hasta 4 EDSFF E3.S NVMe de 5.ª generación con un máximo de 245,76 TB en la parte posterior	Bahías frontales: • 4 SAS/SATA de 3,5 pulgadas • 8 unidades universales o U.2 de 2,5 pulgadas/10 unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas • 10 x 2,5 pulgadas con 4 universales • 16 unidades NVMe EDSFF E3.S de 5.ª generación • 20 unidades EDSFF E3.S y 2 unidades EDSFF E3.S posteriores	Bahías frontales: • 2 SSD U.2 • 12 SAS/SATA de 3,5 pulgadas • 8 unidades universales de 2,5 pulgadas/16 unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas/24 unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas • 16 SSD SAS/SATA de 2,5 in + 8 unidades NVMe U.2 • 8 EDSFF E3.S/16 EDSFF E3.S/32 EDSFF E3.S/40 EDSFF E3.S	Bahías frontales: • 4 SAS/SATA de 3,5 pulgadas • 8 unidades universales o U.2 de 2,5 pulgadas/10 unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas • 10 x 2,5 pulgadas con 4 universales • 8 EDSFF E3.S/16 EDSFF E3.S/20 EDSFF E3.S + 2 EDSFF E3.S posteriores	Bahías frontales: • 12 SAS/SATA de 3,5 pulgadas • 8 unidades universales de 2,5 in/16 SAS/SATA de 2,5 in/24 SAS/SATA de 2,5 in • 16 SAS/SATA de 2,5 pulgadas + 8 U.2 o RAID NVMe de 2,5 pulgadas • 8 EDSFF E3.S/16 EDSFF E3.S/32 EDSFF E3.S/40 EDSFF E3.S	Bahías frontales: • 24 NVMe U.2 de 2,5 pulgadas de 5.ª generación (SSD) con un máximo de 2928 TB	• Sin configuración de backplane • Hasta 8 NVMe (SSD) G5 x4 de 2,5 pulgadas máximo 122,88 TB • Hasta 16 NVMe (SSD) G5 x4 de 2,5 pulgadas máximo 245,76 TB • Hasta 16 NVMe (SSD) G5 x2 de 2,5 pulgadas máximo 245,76 TB • Hasta 32 EDSFF E3. S NVMe de 5.ª generación (SSD) con un máximo de 491,52 TB Compartimientos posteriores: N/D	Bahías frontales: • 4 SAS de 3,5 pulgadas • 8 SAS/SATA de 2,5 pulgadas • 8 U.2 NVMe G4	Bahías frontales: • 12 SAS/SATA de 3,5 pulgadas • 16 SAS/SATA de 2,5 pulgadas
Fuentes de alimentación	• Platinum/Titanium de 800 W y 100-240 VCA o 240 HVDC, redundante y de intercambio en caliente • Platinum/Titanium de 1100 W y 100-240 VCA o 240 HVDC, redundante y de intercambio en caliente • Titanium de 1500 W y 100-240 VCA o 240 HVDC, redundante y de intercambio en caliente • Titanium de 1500 W y 277 VCA y HVDC, redundante y de intercambio en caliente* • Titanium de 1400 W y -48 VCC, redundante y de intercambio en caliente • Titanium de 1800 W y 100-240 VCA o 240 HVDC, redundante de intercambio en caliente*	• Platinum/Titanium de 800 W y 100-240 VCA o 240 HVDC, redundante y de intercambio en caliente • Platinum/Titanium de 1100 W y 100-240 VCA o 240 HVDC, redundante y de intercambio en caliente • Titanium de 1500 W y 100-240 VCA o 240 HVDC, redundante y de intercambio en caliente • Titanium de 1500 W y 277 VCA y HVDC, redundante y de intercambio en caliente* • 1400 W/–48 VCC, redundante y de intercambio en caliente • Titanium de 1800 W y 100-240 VCA o 240 HVDC, redundante de intercambio en caliente*	• Titanium de 1500 W y 100-240 V CA o 240 V CC • Titanium de 1100 W y de 100 a 240 VCA o 240 VDC • Titanium de 800 W y de 100 a 240 VCA o 240 VDC • 1800 W Titanium HLAC: 200-240 VCA o 240 VCC* • Platinum de 1100 W y 100-240 V CA o 240 V CC • Platinum de 800 W y 100-240 V CA o 240 V CC • 1500 W: 277 VCA o 336 VCC* • 1400 W LVDC y de -48 a -60 VCC	• Platinum de 800 W y de 100 a 240 VCA o 240 VDC • Platinum de 1100 W y 100-240 VCA o 240 VCC • Titanium de 1500 W y 100-240 V CA o 240 V CC • Titanium de 1100 W y de 100 a 240 VCA o 240 VDC • Titanium de 3200 W y de 200 a 240 VCA o 240 VDC • Titanium de 800 W y de 100 a 240 VCA o 240 VDC • Titanium de 3200 W, 277 VCA y 336 HVDC • 1400 W, -48 VCC, 60 mm • Titanium de 1500 W, 277 VCA y 336 HVDC* • Titanium de 2400 W y 100-240 VCA o 240 VCC* • 1800 W Titanium HLAC: 200-240 VCA o 240 VCC*	• Platinum: 800 W, 1100 W • Titanium: 800 W, 1100 W, 1500 W, 1500 W y 277 VCA y HVDC*, 1800 W** • Telecomunicaciones: 1400 W y 48 VCC	• Platinum: 800 W, 1100 W • Titanium: 800 W, 1100 W, 1500 W, 1500 W y 277 VCA y HVDC*, 1800 W*, 2400 W*, 3200 W, 3200 W y 277 VCA y HVDC • Telecomunicaciones: 1400 W y 48 VCC	• Platinum: 800 W, 1100 W • Titanium: 800 W, 1100 W, 1500 W, 1500 W con 277 VCA y HVDC*, 1800 W* • Telecomunicaciones: 1400 W y 48 VCC	• Platinum: 800 W, 1100 W • Titanium: 800 W, 1100 W, 1500 W, 1500 W y 277 VCA y HVDC*, 1800 W*, 2400 W*, 3200 W, 3200 W y 277 VCA y HVDC • Telecomunicaciones: 1400 W y 48 VCC	• Titanium de 1500 W y 100-240 VCA o 240 HVDC, redundante y de intercambio en caliente • Titanium de 1800 W y 200-240 VCA o 240 HVDC, redundante y de intercambio en caliente* • Titanium de 2400 W y 100-240 VCA o 240 HVDC, redundante y de intercambio en caliente* • Titanium de 3200 W y 200-240 VCA o 240 HVDC, redundante y de intercambio en caliente	• Titanium de 1500 W y 100-240 VCA o 240 HVDC, redundante y de intercambio en caliente • Titanium de 1800 W y 200-240 VCA o 240 HVDC, redundante y de intercambio en caliente • Titanium de 2400 W y 100-240 VCA o 240 HVDC, redundante y de intercambio en caliente • Titanium de 3200 W y 200-240 VCA o 240 HVDC, redundante y de intercambio en caliente • Titanium de 3200 W y 277 VCA y 336 HVDC, redundante y de intercambio en caliente*	• Platinum: 800 W, 1100 W • Titanium: 800 W, 1100 W • Compatible con FTR	• Platinum: 800 W, 1100 W • Titanium: 800 W, 1100 W • Compatible con FTR

Característica	R470	R570	R670	R770	R6715	R7715	R6725	R7725	R7725xd	R770AP	R4715	R5715
Opciones de enfriamiento:	Enfriamiento por aire	Enfriamiento por aire	• Enfriamiento por aire y enfriamiento por líquido directo	• Enfriamiento por aire y enfriamiento por líquido directo	Enfriamiento por aire, enfriamiento líquido directo (DLC)	Enfriamiento por aire, enfriamiento líquido directo (DLC)	Enfriamiento por aire, enfriamiento líquido directo (DLC)	Enfriamiento por aire, enfriamiento líquido directo (DLC)	Enfriamiento por aire	• Enfriamiento por aire	• Enfriamiento por aire	• Enfriamiento por aire
Ventiladores	• Hasta 4 conjuntos (módulo de ventilador doble) de ventiladores intercambiables en caliente	• Hasta seis ventiladores de conexión en caliente	• Ventiladores de alto rendimiento nivel Silver (HPR SLVR) o nivel estándar (STD) • Hasta 4 juegos (módulo de ventilador doble) de ventiladores intercambiables en caliente	• Ventiladores de alto rendimiento nivel Silver (HPR SLVR) o ventiladores de alto rendimiento nivel Gold (HPR GOLD) • Hasta 6 ventiladores intercambiables en caliente	• Hasta cuatro juegos (módulo de ventilador doble) de ventiladores de conexión en caliente	• Hasta seis ventiladores de conexión en caliente	• Hasta cuatro juegos (módulo de ventilador doble) de ventiladores de conexión en caliente	• Hasta seis ventiladores de conexión en caliente	• Hasta seis ventiladores de conexión en caliente	• Ventiladores de alto rendimiento nivel Gold (HPR GOLD) o ventiladores de alto rendimiento nivel Platinum (HPR PLTM) • Hasta 6 ventiladores intercambiables en caliente	• Hasta cuatro juegos (módulo de ventilador doble) de ventiladores de conexión en caliente	• Hasta seis ventiladores de conexión en caliente
Dimensiones	• Altura = 42,8 mm (1,69 pulgadas) • Ancho: 482 mm (19 pulgadas) • Profundidad: 816,92 mm (32,16 pulgadas) con bisel • Profundidad: 815,14 mm (32,09 pulgadas) sin bisel • Profundidad (configuración de I/O frontal): 829,44 mm (32,09 pulgadas) sin bisel Nota: La configuración de I/O frontal no tendrá un bisel.	• Altura: 86,8 mm (3,42 pulgadas) • Ancho: 482.0 mm (18,98 pulgadas) • Profundidad: 802,38 mm (31,59 pulgadas) con bisel • Profundidad: 801,49 mm (31,55 pulgadas) sin bisel • Profundidad (configuración de I/O frontal/pasillo frío): 814,5 mm (32,06 pulgadas) sin bisel Nota: La configuración de I/O frontal no tendrá un bisel.	Altura = 42,8 mm (1,69 pulgadas) Ancho: 482 mm (18,98 pulgadas) Peso: 20,42 kg (45,02 libras) Profundidad (para la configuración de I/O posterior) • 816,92 mm (32,20 pulgadas) con bisel • 815,14 mm (32,09 pulgadas) sin bisel Profundidad (para la configuración de I/O frontal) • 829,44 mm (32,66 pulgadas) sin bisel Nota: La configuración de I/O frontal no admite el bisel.	• Altura: 86,8 mm (3,42 pulgadas) • Ancho: 482 mm (18,97 in) • Peso: 28,53 kg (62,89 libras) Profundidad (para la configuración de I/O posterior) • 802,40 mm (31,59 pulgadas) con bisel • 801,51 mm (31,56 pulgadas) sin bisel Profundidad (para la configuración de I/O frontal) • 814,52 mm (32,07 pulgadas) sin bisel Nota: La configuración de I/O frontal no soporta el bisel.	• Altura = 42,8 mm (1,68 pulgadas) • Ancho: 482 mm (18,97 pulgadas) • Profundidad: 816,921 mm (32,16 pulgadas) con bisel - 815,141 mm (32,09 pulgadas) sin bisel	• Altura: 86,8 mm (3,41 pulgadas) • Ancho: 482 mm (18,97 pulgadas) • Profundidad: 802,4 mm (31,59 pulgadas) con bisel - 801,51 mm (31,55 pulgadas) sin bisel	• Altura = 42,8 mm (1,68 pulgadas) • Ancho: 482 mm (18,97 in) • Profundidad: 816,921 mm (32,16 pulgadas) con bisel - 815,141 mm (32,09 pulgadas) sin bisel	• Altura: 86,8 mm (3,42 pulgadas) • Ancho: 482 mm (18,98 pulgadas) • Profundidad: 802,4 mm (31,59 pulgadas) con bisel - 801,51 mm (31,55 pulgadas) sin bisel	• Altura: 86,8 mm (3,42 pulgadas) • Ancho: 482 mm (18,98 pulgadas) • Profundidad: 802,4 mm (31,59 pulgadas) con bisel - 801,51 mm (31,55 pulgadas) sin bisel	• Altura: 86,8 mm (3,42 pulgadas) • Ancho: 482 mm (18,97 in) • Peso: 29,30 kg (64,59 libras) • Profundidad: 802,4 mm (31,59 pulgadas) con bisel • 801,51 mm (31,56 pulgadas) sin bisel	• Altura = 42,8 mm (1,68 pulgadas) • Ancho: 482 mm (18,97 pulgadas) • Profundidad: 816,921 mm (32,16 pulgadas) con bisel - 815,141 mm (32,09 pulgadas) sin bisel	• Altura: 86,8 mm (3,41 pulgadas) • Ancho: 482 mm (18,97 pulgadas) • Profundidad: 802,4 mm (31,59 pulgadas) con bisel; 801,51 mm (31,55 pulgadas) sin bisel
Factor de forma	Servidor en rack de 1U	Servidor en rack de 2U	Servidor en rack de 1U	Servidor en rack de 2U	Servidor en rack de 1 U	Servidor en rack de 2U	Servidor en rack de 1 U	Servidor en rack de 2U	Servidor en rack de 2U	Servidor en rack de 2U	Servidor en rack de 1 U	Servidor en rack de 2U
Administración integrada	• iDRAC • iDRAC Direct • API RESTful de iDRAC con Redfish • CLI de RACADM • iDRAC Service Module	• iDRAC • iDRAC Direct • API RESTful de iDRAC con Redfish • CLI RACADM • iDRAC Service Module (iSM)	• iDRAC • iDRAC Direct • API RESTful de iDRAC con Redfish • CLI RACADM • iDRAC Service Module (iSM) • Módulo inalámbrico de Quick Sync 2 • NativeEdge Endpoint* • NativeEdge Orchestrator*	• iDRAC • iDRAC Direct • API RESTful de iDRAC con Redfish • CLI RACADM • iDRAC Service Module (iSM) • Módulo inalámbrico de Quick Sync 2 • NativeEdge Endpoint* • NativeEdge Orchestrator*	• iDRAC10 • iDRAC Direct • API RESTful de iDRAC con Redfish • CLI de RACADM • Módulo inalámbrico de Quick Sync 2	• iDRAC10 • iDRAC Direct • API RESTful de iDRAC con Redfish • CLI de RACADM • Módulo inalámbrico de Quick Sync 2	• iDRAC10 • iDRAC Direct • API RESTful de iDRAC con Redfish • CLI de RACADM • Módulo inalámbrico de Quick Sync 2	• iDRAC10 • iDRAC Direct • API RESTful de iDRAC con Redfish • CLI de RACADM • Módulo inalámbrico de Quick Sync 2	• iDRAC10 • iDRAC Direct • API RESTful de iDRAC con Redfish • CLI de RACADM	• iDRAC10 • iDRAC Direct • API RESTful de iDRAC con Redfish • CLI RACADM • iDRAC Service Module (iSM)	• iDRAC10 • iDRAC Direct • API RESTful de iDRAC con Redfish • CLI de RACADM	• iDRAC 10 • iDRAC Direct • API RESTful de iDRAC con Redfish • CLI de RACADM • Módulo inalámbrico de Quick Sync 2
Bisel	Bisel de seguridad opcional	Bisel de seguridad opcional	Bisel de seguridad opcional	Bisel de seguridad opcional	Bisel metálico opcional	Bisel metálico opcional	Bisel metálico opcional	Bisel metálico opcional	Bisel metálico opcional	Bisel de seguridad opcional	Bisel metálico opcional	Bisel metálico opcional
Software OpenManage	• OpenManage Enterprise (OME) • OME Power Manager • OME Services • OME Update Manager • OME APEX AIOps Observability • OME Integration for VMware vCenter (con VMware Aria Operations) • OME Integration para Microsoft System Center • OpenManage para Windows Systems Center	• OpenManage Enterprise (OME) • OME Power Manager • OME Services • OME Update Manager • OME APEX AIOps Observability • OME Integration for VMware vCenter (con VMware Aria Operations) • OME Integration para Microsoft System Center • OpenManage para Windows Systems Center	• OpenManage Enterprise (OME) • OME Power Manager • OME Services • OME Update Manager • OME APEX AIOps Observability • OME Integration for VMware vCenter (con VMware Aria Operations) • OME Integration para Microsoft System Center • OpenManage para Windows Systems Center	• OpenManage Enterprise (OME) • OME Power Manager • OME Services • OME Update Manager • OME APEX AIOps Observability • OME Integration for VMware vCenter (con VMware Aria Operations) • OME Integration para Microsoft System Center • OpenManage para Windows Systems Center	• OpenManage Enterprise (OME) • OME Power Manager • OME Services • OME Update Manager • OME APEX AIOps Observability • OME Integration for VMware vCenter (con VMware Aria Operations) • OME Integration para Microsoft System Center • OpenManage para Windows Systems Center	• OpenManage Enterprise (OME) • OME Power Manager • OME Services • OME Update Manager • OME APEX AIOps Observability • OME Integration for VMware vCenter (con VMware Aria Operations) • OME Integration para Microsoft System Center • OpenManage para Windows Systems Center	• OpenManage Enterprise (OME) • OME Power Manager • OME Services • OME Update Manager • OME APEX AIOps Observability • OME Integration for VMware vCenter (con VMware Aria Operations) • OME Integration para Microsoft System Center • OpenManage para Windows Systems Center	• OpenManage Enterprise (OME) • OME Power Manager • OME Services • OME Update Manager • OME APEX AIOps Observability • OME Integration for VMware vCenter (con VMware Aria Operations) • OME Integration para Microsoft System Center • OpenManage para Windows Systems Center	• OpenManage Enterprise (OME) • OME Power Manager • OME Services • OME Update Manager • OME APEX AIOps Observability • OME Integration for VMware vCenter (con VMware Aria Operations) • OME Integration para Microsoft System Center • OpenManage para Windows Systems Center	• OpenManage Enterprise (OME) • OME Power Manager • OME Services • OME Update Manager • OME APEX AIOps Observability • OME Integration for VMware vCenter (con VMware Aria Operations) • OME Integration para Microsoft System Center • OpenManage para Windows Systems Center	• OpenManage Enterprise (OME) • OME Power Manager • OME Services • OME Update Manager • OME APEX AIOps Observability • OME Integration for VMware vCenter (con VMware Aria Operations) • OME Integration para Microsoft System Center • OpenManage para Windows Systems Center

Característica	R470	R570	R670	R770	R6715	R7715	R6725	R7725	R7725xd	R770AP	R4715	R5715
Herramientas	IPMI	IPMI	IPMI	IPMI	IPMI	IPMI	IPMI	IPMI	IPMI	IPMI	**IPMI**	**IPMI**
Integraciones y conexiones	OpenManage Integrations • Colecciones de Red Hat Ansible • Proveedores de Terraform	OpenManage Integrations • Colecciones de Red Hat Ansible • Proveedores de Terraform	OpenManage Integrations • Colecciones de Red Hat Ansible • Proveedores de Terraform	OpenManage Integrations • Colecciones de Red Hat Ansible • Proveedores de Terraform	OpenManage Integrations • Colecciones de Red Hat Ansible • Proveedores de Terraform	OpenManage Integrations • Colecciones de Red Hat Ansible • Proveedores de Terraform	OpenManage Integrations • Colecciones de Red Hat Ansible • Proveedores de Terraform	OpenManage Integrations • Colecciones Ansible de Red Hat • Proveedores de Terraform	OpenManage Integrations • Colecciones Ansible de Red Hat • Proveedores de Terraform	OpenManage Integrations • Colecciones de Red Hat Ansible • Proveedores de Terraform	OpenManage Integrations • Colecciones de Red Hat Ansible • Proveedores de Terraform	OpenManage Integrations • Colecciones de Red Hat Ansible • Proveedores de Terraform
Administración de cambios	• Dell Repository Manager • Actualización del sistema Dell • Catálogos empresariales • Server Update Utility (SUU)*	• Dell Repository Manager • Actualización del sistema Dell • Catálogos empresariales • Server Update Utility (SUU)*	• Dell Repository Manager • Actualización del sistema Dell • Catálogos empresariales • Server Update Utility (SUU)*	• Dell Repository Manager • Actualización del sistema Dell • Catálogos empresariales • Server Update Utility (SUU)*	• Dell Repository Manager • Actualización del sistema Dell • Catálogos empresariales • Server Update Utility (SUU)*	• Dell Repository Manager • Actualización del sistema Dell • Catálogos empresariales • Server Update Utility (SUU)*	• Dell Repository Manager • Actualización del sistema Dell • Catálogos empresariales • Server Update Utility (SUU)*	• Dell Repository Manager • Actualización del sistema Dell • Catálogos empresariales • Server Update Utility (SUU)*	• Dell Repository Manager • Actualización del sistema Dell • Catálogos empresariales • Server Update Utility (SUU)*	• Dell Repository Manager • Actualización del sistema Dell • Catálogos empresariales • Server Update Utility (SUU)*	• Dell Repository Manager • Actualización del sistema Dell • Catálogos empresariales • Server Update Utility (SUU)	• Dell Repository Manager • Actualización del sistema Dell • Catálogos empresariales • Server Update Utility (SUU)
Seguridad	• Firmware firmado criptográficamente • Cifrado de datos en reposo (SED con administración de claves local o externa) • Arranque seguro • Verificación de componentes protegidos (comprobación de integridad de hardware) • Borrado seguro • Raíz de confianza de silicio • Bloqueo del sistema (requiere iDRAC10 Enterprise o Datacenter) • FIPS de TPM 2.0, con certificado de CC-TCG • Detección de intrusiones al chasis	• Firmware firmado criptográficamente • Cifrado de datos en reposo (SED con administración de claves local o externa) • Arranque seguro • Verificación de componentes protegidos (comprobación de integridad de hardware) • Borrado seguro • Raíz de confianza de silicio • Bloqueo del sistema • FIPS de TPM 2.0, con certificado de CC-TCG • Detección de intrusiones al chasis	• Firmware firmado criptográficamente • Cifrado de datos en reposo (SED con administración de claves local o externa) • Arranque seguro • Verificación de componentes protegidos (comprobación de integridad de hardware) • Borrado seguro • Raíz de confianza de silicio • Bloqueo del sistema • FIPS de TPM 2.0, con certificado de CC-TCG • Detección de intrusiones al chasis	• Firmware firmado criptográficamente • Cifrado de datos en reposo (SED con administración de claves local o externa) • Arranque seguro • Verificación de componentes protegidos (comprobación de integridad de hardware) • Raíz de confianza de silicio • Bloqueo del sistema • Bloqueo del sistema (requiere iDRAC10 Enterprise o Datacenter) • Detección de intrusiones al chasis • FIPS de TPM 2.0, con certificado de CC-TCG	• Firmware firmado criptográficamente • Cifrado de datos en reposo (SED con administración de claves local o externa) • Arranque seguro • Verificación de componentes protegidos (comprobación de integridad de hardware) • Borrado seguro • Raíz de confianza de silicio • Bloqueo del sistema • FIPS de TPM 2.0, con certificado de CC-TCG • Detección de intrusiones al chasis	• Virtualización segura cifrada de AMD (SEV) • Cifrado de memoria seguro de AMD (SME) • Firmware firmado criptográficamente • Cifrado de datos en reposo (SED con administración de claves local o externa) • Arranque seguro • Verificación de componentes protegidos (comprobación de integridad de hardware) • Borrado seguro • Raíz de confianza de silicio • Bloqueo del sistema • FIPS de TPM 2.0, con certificado de CC-TCG • Detección de intrusiones al chasis	• Firmware firmado criptográficamente • Cifrado de datos en reposo (SED con administración de claves local o externa) • Arranque seguro • Verificación de componentes protegidos (comprobación de integridad de hardware) • Borrado seguro • Raíz de confianza de silicio • Bloqueo del sistema • FIPS de TPM 2.0, con certificado de CC-TCG • Detección de intrusiones al chasis	• Firmware firmado criptográficamente • Cifrado de datos en reposo (SED con administración de claves local o externa) • Arranque seguro • Verificación de componentes protegidos (comprobación de integridad de hardware) • Borrado seguro • Raíz de confianza de silicio • Bloqueo del sistema • FIPS de TPM 2.0, con certificado de CC-TCG • Detección de intrusiones al chasis	• Firmware firmado criptográficamente • Cifrado de datos en reposo (SED con administración de claves local o externa) • Arranque seguro • Verificación de componentes protegidos (comprobación de integridad de hardware) • Borrado seguro • Raíz de confianza de silicio • Bloqueo del sistema (requiere iDRAC10 Enterprise o Datacenter) • FIPS de TPM 2.0, con certificado de CC-TCG • Detección de intrusiones al chasis	• Virtualización segura cifrada de AMD (SEV) • Cifrado de memoria seguro de AMD (SME) • Firmware firmado criptográficamente • Cifrado de datos en reposo (SED con administración de claves local o externa) • Arranque seguro • Verificación de componentes protegidos (comprobación de integridad de hardware) • Borrado seguro • Raíz de confianza de silicio • Bloqueo del sistema • FIPS de TPM 2.0, con certificado de CC-TCG • Detección de intrusiones al chasis
Opciones de soporte vertical de OCP	• Hasta dos tarjetas NIC de OCP 3.0: 2 ranuras en la parte frontal o 2 ranuras en la parte posterior (opcional) Ranura 2: 1 x16 OCP 3.0 Ranura 5: 1 x16 OCP 3.0 Ranura 31: 1 x16 OCP 3.0 Ranura 32: 1 x16 OCP 3.0	• Hasta dos tarjetas NIC de OCP 3.0: 2 ranuras en la parte frontal o 2 ranuras en la parte posterior (opcional) Ranura 4: 1 x16 OCP 3.0 Ranura 10: 1 x16 OCP 3.0 Ranura 34: 1 x16 OCP 3.0 Ranura 38: 1 x16 OCP 3.0	2 tarjetas NIC OCP 3.0 (opcionales) y 1 GbE, 10 GbE, 25 GbE, 100 GbE y 400 GbE* (Parte frontal) Ranura 31: 1 x16 OCP 3.0 en la tarjeta elevadora frontal Ranura 32: 1 x16 OCP 3.0 en la tarjeta elevadora frontal (Parte posterior) Ranura 2: 1 x16 OCP 3.0 Ranura 5: 1 x8 OCP 3.0 de 5.ª generación o 1 x16 OCP 3.0 de 5.ª generación	Hasta 2 tarjetas NIC OCP 3.0 (opcionales) compatibles con 1 GbE, 10 GbE, 25 GbE, 100 GbE y 400 GbE* Ranuras compatibles con OCP: (Parte frontal) Ranura 34: 1 x16 con OCP 3.0 de 5.ª generación en la tarjeta elevadora frontal Ranura 38: 1 x16 con OCP 3.0 de 5.ª generación en la tarjeta elevadora frontal (Parte posterior) Ranura 4: 1 x8 o 1 x16 OCP 3.0 de 5.ª generación Ranura 10: 1 x8 o 1 x16 OCP 3.0	• 2 tarjetas OCP 3.0 (opcionales) y 1 GbE, 10 GbE, 25 GbE, 100 GbE y 400 GbE • Ranura 2: 1 x16 OCP 3.0 de 5.ª generación • Ranura 5: 1 x16 OCP 3.0 de 5.ª generación	2 tarjetas NIC OCP 3.0 (opcionales) y 1 GbE, 10 GbE, 25 GbE, 100 GbE y 400 GbE • Ranura 4: 1 x16 OCP 3.0 de 5.ª generación • Ranura 10: 1 x16 OCP 3.0 de 5.ª generación	2 tarjetas OCP 3.0 (opcionales) y 1 GbE, 10 GbE, 25 GbE, 100 GbE y 400 GbE • Ranura 2: 1 x16 OCP 3.0 de 5.ª generación • Ranura 5: 1 x16 OCP 3.0 de 5.ª generación	• 2 tarjetas NIC OCP 3.0 (opcionales) y 1 GbE, 10 GbE, 25 GbE, 100 GbE y 400 GbE • Ranura 4: 1 x16 de 5.ª generación con OCP 3.0 secundaria • Ranura 10: 1 x16 OCP 3.0 de 5.ª generación	• 1 NIC OPC 3.0 de 3.ª generación (opcional); 10 GbE • Ranura 10: 1 x4 OCP 3.0 de 3.ª generación	• 2 tarjetas NIC OCP 3.0 (opcionales) y 1 GbE, 10 GbE, 25 GbE y 200 GbE • Ranura 4: 1 x8 o 1 x16 OCP 3.0 de 5.ª generación • Ranura 10: 1 x16 OCP 3.0 de 5.ª generación	• 2 tarjetas OCP 3.0 (opcionales) y 1 GbE, 10 GbE y 25 GbE. • Ranura 2: 1 x16 OCP 3.0 de 5.ª generación • Ranura 5: 1 x16 OCP 3.0 de 5.ª generación	• 2 tarjetas NIC OCP 3.0 (opcionales) y 1 GbE, 10 GbE y 25 GbE • Ranura 4: 1 x16 OCP 3.0 de 5.ª generación • Ranura 10: 1 x16 OCP 3.0 de 5.ª generación
BOSS	Ranura 34: 1 x4 BOSS Ranura 3: 1 x4 BOSS	Ranura 34: 1 x4 BOSS Ranura 6: 1 x4 BOSS	Ranura 34: 1 x 4 BOSS Ranura 3: 1 x 4 BOSS	Ranura 34: 1 x4 BOSS Ranura 6: 1 x4 BOSS	Ranura 3: 1 x4 BOSS	Ranura 6: 1 x4 BOSS	Ranura 3: 1 x4 BOSS	Ranura 6: 1 x4 BOSS	Ranura 6: 1 x4 BOSS	Ranura 6: 1 x4 BOSS	Ranura 3: 1 x4 BOSS	Ranura 6: 1 x4 BOSS
NIC integrada	1 puerto Ethernet BMC de 1 GB dedicado	1 puerto Ethernet BMC de 1 GB dedicado	1 puerto Ethernet BMC de 1 GB dedicado	1 puerto Ethernet BMC de 1 GB dedicado	1 puerto Ethernet BMC de 1 GB dedicado	1 puerto Ethernet BMC de 1 GB dedicado	1 puerto Ethernet BMC de 1 GB dedicado	1 puerto Ethernet BMC de 1 GB dedicado	1 puerto Ethernet BMC de 1 GB dedicado	1 puerto Ethernet BMC de 1 GB dedicado	1 puerto Ethernet BMC de 1 GB dedicado	1 puerto Ethernet BMC de 1 GB dedicado

Característica	R470	R570	R670	R770	R6715	R7715	R6725	R7725	R7725xd	R770AP	R4715	R5715
NIC de tarjeta adicional (AIC) PCIe	NA	NA	NA	NA	100 GbE y 400 GbE; NDR VPI (400 GbE); FC 32	100 GbE y 400 GbE; NDR VPI (400 GbE); FC 32	100 GbE y 400 GbE; NDR VPI (400 GbE); FC 32/64	100 GbE y 400 GbE; NDR VPI (400 GbE); FC 32/64	100 GbE y 400 GbE; NDR VPI (400 GbE)	NA	100 GbE y 400 GbE; NDR VPI (400 GbE)	100 GbE y 400 GbE; NDR VPI (400 GbE)
Opciones de GPU	Hasta 4 x 75 W SW	Hasta 3 de 400 W de DW; hasta 4 de 75 W de SW	Hasta 3 x 75 W SW	Hasta 6 x 75 W de FHHL* o hasta 2 x 450 W de DWFL*	Hasta 3 x 75 W SW	Hasta 3 de 450 W de DW*; hasta 6 de 75 W de SW	Hasta 3 x 75 W SW	Hasta 2 de 450 W de DW*; hasta 6 de 75 W de SW	NA	NA	NA	NA
Opciones de DPU	NVIDIA Bluefield-3 2 x 200 GbE B3220	NVIDIA Bluefield-3 2 x 200 GbE B3220	• NVIDIA Bluefield-3 2 x 200 GbE B3220 • NVIDIA Bluefield-3 1 x 400 GbE B3140H	• NVIDIA Bluefield-3 2 x 200 GbE B3220 • NVIDIA Bluefield-3 1 x 400 GbE B3140H	• NVIDIA Bluefield-3 2 x 200 GbE B3220 • NVIDIA Bluefield-3 1 x 400 GbE B3140H*	• NVIDIA Bluefield-3 2 x 200 GbE B3220 • NVIDIA Bluefield-3 1 x 400 GbE B3140H*	• NVIDIA Bluefield-3 2 x 200 GbE B3220 • NVIDIA Bluefield-3 1 x 400 GbE B3140H*	• NVIDIA Bluefield-3 2 x 200 GbE B3220 • NVIDIA Bluefield-3 1 x 400 GbE B3140H*	NA	NA	NA	NA
Puertos	Puertos frontales • 1 puerto USB 2.0 Type-C • 1 puerto USB 2.0 Type-A (opcional) • 1 Mini DisplayPort (opcional) • 1 serie DB9 (con configuración de I/O frontal) • 1 puerto Ethernet BMC dedicado (con configuración de I/O frontal) Puertos posteriores • 1 puerto Ethernet BMC dedicado • 2 puertos USB 3.1 Type-A • 1 VGA Puertos internos • 1 puerto USB 3.1 Type-A	Puertos frontales • 1 USB 2.0 tipo C (HOST/BMC directo) • 1 USB 2.0 tipo A (LCP opcional: KVM secundario) • 1 mini DisplayPort (LCP opcional: KVM secundario) • 1 serie DB9 (con configuración de I/O frontal) • 1 puerto Ethernet BMC dedicado (con configuración de I/O frontal) Puertos posteriores • 1 puerto Ethernet BMC dedicado • 2 puertos USB 3.1 tipo A • 1 VGA Puerto interno • 1 puertos USB 3.1 tipo A	Puertos frontales: • 1 puerto USB 2.0 Type-C • 1 puerto USB 2.0 Type-A (opcional) • 1 Mini DisplayPort (opcional) • 1 serie DB9 (con configuración de I/O frontal) • 1 puerto Ethernet dedicado para la administración de iDRAC Puertos posteriores: • 1 puerto Ethernet dedicado para la administración de iDRAC • 1 VGA • 2 puertos USB 3.1 Type-A Puertos internos: • 1 puerto USB 3.1 Type-A	Puertos frontales: • 1 puerto USB 2.0 Type-C • 1 puerto USB 2.0 Type-A (opcional) • 1 Mini DisplayPort (opcional) • 1 serie DB9 (con configuración de I/O frontal) • 1 puerto Ethernet dedicado para la administración de iDRAC Puertos posteriores: • 1 puerto Ethernet dedicado para la administración de iDRAC • 1 VGA • 2 puertos USB 3.1 Type-A Puertos internos: • 1 puerto USB 3.1 Type-A	Puertos frontales • 1 USB 2.0 tipo A (KVM LCP opcional) • 1 USB 2.0 tipo C (HOST/BMC directo) • 1 puerto MiniDisplay (KVM LCP opcional) Puertos posteriores • 2 USB 3.1 Type-A • 1 VGA • 1 puerto Ethernet BMC de 1 GB dedicado Puerto interno • 1 puertos USB 3.1 tipo A	Puertos frontales • 1 USB 2.0 tipo A (KVM LCP opcional) • 1 USB 2.0 tipo C (HOST/BMC directo) • 1 mini DisplayPort (KVM LCP opcional) Puertos posteriores • 1 puerto Ethernet BMC dedicado de 1 Gb • 2 puertos USB 3.1 tipo A • 1 VGA Puerto interno • 1 puertos USB 3.1 tipo A	Puertos frontales • 1 USB 2.0 tipo A (KVM LCP opcional) • 1 USB 2.0 tipo C (HOST/BMC directo) • 1 mini DisplayPort (KVM LCP opcional) Puertos posteriores • 1 puerto Ethernet BMC dedicado de 1 Gb • 2 puertos USB 3.1 tipo A • 1 VGA Puerto interno • 1 puertos USB 3.1 tipo A	Puertos frontales • 1 USB 2.0 tipo A (KVM LCP opcional) • 1 USB 2.0 tipo C (HOST/BMC directo) • 1 puerto Mini DisplayPort (KVM LCP opcional) Puertos posteriores • 1 puerto Ethernet BMC dedicado • 2 puertos USB 3.1 tipo A • 1 VGA Puerto interno • 1 puertos USB 3.1 tipo A	Puertos frontales • 1 USB 2.0 tipo A (LCP opcional: KVM secundario) • 1 USB 2.0 tipo C (HOST/BMC directo) • 1 puerto Mini DisplayPort (LCP opcional: KVM secundario) Puertos posteriores • 1 puerto Ethernet BMC dedicado • 2 puertos USB 3.1 tipo A • 1 VGA Puerto interno • 1 puertos USB 3.1 tipo A	Puertos frontales: • 1 puerto USB 2.0 Type-C Puertos posteriores: • 1 puerto Ethernet dedicado para la administración de iDRAC • 1 VGA • 2 puertos USB 3.1 Type-A Puertos internos: • 1 puerto USB 3.1 Type-A	Puertos frontales • 1 USB 2.0 tipo A (KVM LCP opcional) • 1 USB 2.0 tipo C (HOST/BMC directo) • 1 puerto MiniDisplay (KVM LCP opcional) Puertos posteriores • 2 USB 3.1 Type-A • 1 VGA • 1 puerto Ethernet BMC de 1 GB dedicado Puerto interno • 1 puertos USB 3.1 tipo A	Puertos frontales • 1 USB 2.0 tipo A (KVM LCP opcional) • 1 USB 2.0 tipo C (HOST/BMC directo) • 1 puerto MiniDisplay (KVM LCP opcional) Puertos posteriores • 2 USB 3.1 Type-A • 1 VGA • 1 puerto Ethernet BMC de 1 GB dedicado Puerto interno • 1 puertos USB 3.1 tipo A

Característica	R470	R570	R670	R770	R6715	R7715	R6725	R7725	R7725xd	R770AP	R4715	R5715
Ranuras PCIe	Hasta 4 ranuras PCIe de 5.ª generación (conectores x16) • Ranura 1: 1 x8 de 5.ª generación y bajo perfil • Ranura 1: 1 x16 de 5.ª generación (conector x16) de altura completa y longitud media en tarjeta elevadora posterior • Ranura 4: 1 x16 de 5.ª generación (conector x16) de altura completa y longitud media en tarjeta elevadora posterior • Ranura 31: 1 x16 de 5.ª generación (conector x16) de altura completa y longitud media en tarjeta elevadora posterior • Ranura 32: 1 x16 de 5.ª generación (conector x16) de altura completa y longitud media en tarjeta elevadora posterior	Hasta seis ranuras PCIe (conector x16) • Ranura 2: 1 x16 de 5.ª generación de altura completa y longitud media o 1 x16 de altura completa y longitud completa • Ranura 3: 1 x16 de 5.ª generación de altura completa y longitud media • Ranura 4: 1 x16 de 5.ª generación de altura completa y longitud media, 1 x16 de altura completa y longitud completa o 1 x16 OCP 3.0 • Ranura 6: 1 x4 BOSS de 4.ª generación (opcional) • Ranura 7: 1 x16 de 5.ª generación de altura completa y longitud media o 1 x16 de altura completa y longitud completa • Ranura 9: 1 x16 de 5.ª generación de altura completa y longitud media • Ranura 10: 1 x16 OCP 3.0 • Ranura 31: 1 x16 de 5.ª generación de altura completa y longitud media • Ranura 34: 1 x16 OCP 3.0 o 1 x4 BOSS de 4.ª generación (opcional) • Ranura 36: 1 x16 de 5.ª generación de altura completa y longitud media • Ranura 38: 1 x16 OCP 3.0	• Hasta dos ranuras PCIe (conectores x16) • Ranura 31: 1 x 16 de altura completa y longitud media o altura completa y longitud completa o 1 x 16 OCP 3.0 en la tarjeta elevadora frontal • Ranura 32: 1 x 16 de altura completa y longitud media o altura completa y longitud completa o 1 x 16 OCP 3.0 en la tarjeta elevadora frontal • Hasta 3 x 16 o 2 x 8 ranuras PCIe de 5.ª generación • Ranura 1: 1 x 16 de altura completa y longitud media o altura completa y longitud completa o 3 x 16 o 1 x 8 de perfil bajo y longitud media • Ranura 2: 1 x 16 o 1 x 8 de perfil bajo y longitud media o 1 x 16 OCP 3.0 • Ranura 4: 1 x 16 de altura completa y longitud media o 1 x 16 de perfil bajo y longitud media	• Hasta dos ranuras PCIe (conectores x16) • Ranura 31: 1 x 16 de 5.ª generación de altura completa y longitud media o longitud completa en la tarjeta elevadora frontal • Ranura 36: 1 x 16 de 5.ª generación de altura completa y longitud media en la tarjeta elevadora frontal • Hasta ocho ranuras PCIe* (conectores x8 o x16) • Ranura 1: 1 x 8 de 5.ª generación de altura completa y longitud media • Ranura 2: 1 x 16 de 5.ª generación de ancho doble y longitud completa o 1 x 8 de 5.ª generación de altura completa y longitud media • Ranura 3: 1 x 16 de 5.ª generación de altura completa y longitud media o 1 x 16 de 5.ª generación de bajo perfil • Ranura 4: 1 x 16 de 5.ª generación de altura completa y longitud media o 1 x 8 de 5.ª generación de altura completa y longitud media o 1 x 8 o 1 x 16 con OCP 3.0 • Ranura 5: 2 x 16 de 5.ª generación de altura completa y longitud media o 1 x 8 de 5.ª generación de altura completa y longitud media • Ranura 7: 1 x 16 de 5.ª generación de altura completa y longitud media o 1 x 16 de 5.ª generación de ancho doble de longitud completa o 1 x 8 de 5.ª generación de altura completa y longitud media • Ranura 8: 1 x 16 de 5.ª generación de altura completa y longitud media o 1 x 8 de 5.ª generación de altura completa y longitud media • Ranura 9: 1 x 16 de 5.ª generación de altura completa y longitud media o 1 x 8 de 5.ª generación de altura completa y longitud media o 1 x 16 de bajo perfil y longitud media	Hasta tres ranuras de PCIe (conector x16) • Ranura 1: 1 x16 de 5.ª generación de altura completa o bajo perfil • Ranura 2: 1 x16 de 5.ª generación de bajo perfil o 1 x16 OCP3.0 • Ranura 4: 1 x16 de 5.ª generación de altura completa o bajo perfil	Hasta ocho ranuras de PCIe (conectores x16) • Ranura 1: 1 x16 de 5.ª generación de altura completa • Ranura 2: 1 x16 de 5.ª generación de altura completa o 1 x16 de ancho doble y longitud completa • Ranura 3: 1 x16 de 5.ª generación de altura completa o perfil bajo • Ranura 4: 1 x16 de 5.ª generación de altura completa, 1 x16 de ancho doble y longitud completa o 1 x16 OCP 3.0 • Ranura 5: 1 x16 de 5.ª generación de altura completa • Ranura 7: 1 x16 de 5.ª generación de altura completa o 1 x16 de ancho doble y longitud completa • Ranura 8: 1 x16 de 5.ª generación de altura completa • Ranura 9: 1 x16 de 5.ª generación de altura completa o perfil bajo	Hasta tres ranuras de PCIe (conector x16) • Ranura 1: 1 x16 de 5.ª generación de altura completa o perfil bajo • Ranura 2: 1 x16 de 5.ª generación de bajo perfil o 1 x16 OCP3.0 • Ranura 4: 1 x16 de 5.ª generación de altura completa o bajo perfil	Hasta ocho ranuras de PCIe (conector x8 o x16) • Ranura 1: 1 x8 de 5.ª generación de altura completa • Ranura 2: 1 x16 de 5.ª generación de altura completa, 1 x8 de 5.ª generación de altura completa o 1 x16 de ancho doble y longitud completa • Ranura 3: 1 x16 de 5.ª generación de altura completa o perfil bajo • Ranura 4: 1 x16 de 5.ª generación de altura completa, 1 x8 de 5.ª generación de altura completa o 1 x16 OCP 3.0 • Ranura 5: 1 x8 de 5.ª generación de altura completa • Ranura 7: 1 x16 de 5.ª generación de altura completa, 1 x8 de 5.ª generación de altura completa o 1 x16 de ancho doble y longitud completa • Ranura 8: 1 x16 de 5.ª generación de altura completa o 1 x8 de 5.ª generación de altura completa • Ranura 9: 1 x16 de 5.ª generación de altura completa o perfil bajo	Hasta 5 ranuras PCIe de 5.ª generación (conectores x16)* • Ranura 2: 1 x16 de 5.ª generación de altura completa • Ranura 3: 1 x16 de 5.ª generación de altura completa o 1 x16 de 5.ª generación de bajo perfil • Ranura 4: 1 x16 de 5.ª generación de altura completa* • Ranura 7: 1 x16 de 5.ª generación de altura completa • Ranura 8: 1 x16 de 5.ª generación de altura completa • Ranura 9: 1 x16 de 5.ª generación y bajo perfil	Hasta cinco ranuras PCIe (conector x16) • Ranura 2: 1 x16 de 5.ª generación (conector x16) de altura completa y longitud media • Ranura 3: 1 x16 de 5.ª generación (conector x16) de altura completa o bajo perfil y longitud media • Ranura 9: 1 x16 de 5.ª generación (conector x16) de altura completa o bajo perfil y longitud media • Ranura 7: 1 x16 de 5.ª generación (conector x16) de altura completa y longitud media • Ranura 5: 1 x16 de 5.ª generación (conector x16) de altura completa y longitud media	Hasta tres ranuras de PCIe (conector x16) • Ranura 1: 1 x16 de 5.ª generación de altura completa o bajo perfil • Ranura 2: 1 x16 de 5.ª generación de bajo perfil o 1 x16 OCP3.0 • Ranura 4: 1 x16 de 5.ª generación de altura completa o bajo perfil	Hasta tres ranuras de PCIe (conector x16) • Ranura 2: 1 x16 de 5.ª generación de altura completa • Ranura 3: 1 x16 de 5.ª generación de altura completa • Ranura 7: 1 x16 de 5.ª generación de altura completa • Ranura 9: 1 x16 de 5.ª generación de altura completa
Ranuras PCIe de 5.ª generación	4	4	3	8	3	8	3	8	5*	5	**3**	**4**

Característica	R470	R570	R670	R770	R6715	R7715	R6725	R7725	R7725xd	R770AP	R4715	R5715
Sistema operativo e hipervisores	• Canonical Ubuntu Server LTS • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi • Windows Server • Windows Server Datacenter Para obtener información sobre las especificaciones y la interoperabilidad, consulte Dell.com/OSsupport.	• Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server con Hyper-V • RedHat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi Para obtener información sobre las especificaciones y la interoperabilidad, consulte Dell.com/OSsupport.	• Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server con Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi • SO Dell NativeEdge* Para obtener especificaciones y detalles de interoperabilidad, consulte Dell.com/OSsupport.	• Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server con Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi • SO Dell NativeEdge* Para obtener información sobre las especificaciones y la interoperabilidad, consulte Dell.com/OSsupport.	• Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server con Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi Para obtener información sobre las especificaciones y la interoperabilidad, consulte Dell.com/OSsupport.	• Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server con Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi Para obtener información sobre las especificaciones y la interoperabilidad, consulte Dell.com/OSsupport.	• Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server con Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi Para obtener especificaciones y detalles de interoperabilidad, consulte Dell.com/OSsupport	• Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server con Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi Para obtener información sobre las especificaciones y la interoperabilidad, consulte Dell.com/OSsupport.	• Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server con Hyper-V* • RedHat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server Para obtener especificaciones y detalles de interoperabilidad, consulte Dell.com/OSsupport	• Canonical Ubuntu Server LTS • Windows Server • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware vSAN/ESXi* • Microsoft Windows 2025 Para obtener información sobre las especificaciones y la interoperabilidad, consulte Dell.com/OSsupport.	• Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server con Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi Para obtener información sobre las especificaciones y la interoperabilidad, consulte Dell.com/OSsupport.	• Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server con Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi Para obtener información sobre las especificaciones y la interoperabilidad, consulte Dell.com/OSsupport.
Versión preparada para OEM disponible	Desde el bisel hasta el BIOS y el embalaje, sus servidores pueden verse y sentirse como si fueran diseñados y construidos por usted. Para obtener más información, visite Dell.com/OEM.											

Nota: * Es posible que las características marcadas con un asterisco (*) no estén disponibles en el lanzamiento del producto. Consulte la página del configurador del producto en Dell.com para confirmar la disponibilidad de las características.

Para comprar servidores Dell PowerEdge, consulte Dell.com.

Para obtener más información sobre las especificaciones específicas de la plataforma y detalles adicionales, consulte la Guía técnica en Dell.com.

Servidor en rack	R260	R360	R660	R760	R860	R960	R660xs	R760xs	R760xd2	R760xa
										
Atributos clave	Servidor en rack de poca profundidad con bisel filtrante para clientes cercanos al borde con los últimos procesadores Intel Xeon serie 6300, memoria DDR5, BOSS NVMe y PSU Energy Star 4.0	Productividad optimizada, GPU empresarial de alto rendimiento y computación potente para abordar aplicaciones de negocio comunes.	Proporciona rendimiento y versatilidad para aplicaciones exigentes	Proporciona rendimiento y versatilidad para aplicaciones exigentes	Potencie las cargas de trabajo principales y críticas del negocio con computación de alta densidad	Aceleración extrema para la continuidad comercial y el escalamiento horizontal	Tamaño adecuado para las aplicaciones de TI más populares	Tamaño adecuado para las aplicaciones de TI más populares	Almacenamiento denso, recuperación y escalabilidad más rápidas	Servidor escalable de alto rendimiento para aplicaciones GPU intensivas
Cargas de trabajo objetivo	Colaboración y uso compartido, correo y mensajería, aplicaciones cercanas al borde	Colaboración y uso compartido, correo y mensajería, base de datos	Virtualización de alta densidad, análisis de base de datos densa, estandarización de cargas de trabajo mixtas	Estandarización de cargas de trabajo mixtas, base de datos y analítica, infraestructura de escritorio virtual	Grandes bases de datos en la memoria, análisis de datos, IA y virtualización, infraestructura de escritorios virtuales (VDI)		Virtualización, nube, base de datos de escalamiento horizontal, recursos informáticos de alto rendimiento (HPC)	Virtualización, almacenamiento definido por software, densidad de VM media o VDI	Almacenamiento de archivos y objetos, captura de video y vigilancia, streaming de video	Capacitación e inferencia de AI/ML/DL Gemelos digitales, gráficos de representación Gráficos de virtualización y VDI
Tipo de procesador	1 procesador Intel Xeon serie 6300 con hasta 8 núcleos o Un procesador Intel Xeon serie E-2400 con hasta 8 núcleos o 1 procesador Intel Pentium con 2 núcleos	1 procesador Intel Xeon serie 6300 con hasta 8 núcleos o Un procesador Intel Xeon serie E-2400 con hasta 8 núcleos o 1 procesador Intel Pentium con 2 núcleos	2 procesadores escalables Intel Xeon de 4.ª generación; hasta 56 núcleos por procesador o 2 procesadores escalables Intel Xeon de 5.ª generación; hasta 64 núcleos por procesador		Cuatro procesadores escalables Intel Xeon de 4.ª generación con hasta 60 núcleos por procesador y con tecnología Intel QuickAssist opcional		Hasta 2 procesadores escalables Intel Xeon de 5.ª generación con 28 núcleos o Dos procesadores escalables Intel Xeon de 4.ª generación con hasta 32 núcleos por procesador		2 procesadores escalables Intel Xeon de 4.ª generación; hasta 32 núcleos por procesador o 2 procesadores escalables Intel Xeon de 5.ª generación; hasta 28 núcleos por procesador	2 procesadores escalables Intel Xeon de 4.ª generación; hasta 56 núcleos por procesador o 2 procesadores escalables Intel Xeon de 5.ª generación; hasta 64 núcleos por procesador
Ranuras DIMM DDR5 (capacidad máxima)	4 (128 GB)	4 (128 GB)	32 (8 TB)		64 (16 TB)		16 (1,5 TB)	16 (1,5 TB)	16 (1,5 TB)	32 (8 TB)
Unidades de disco hasta:	2 x 3,5 pulgadas 6 x 2,5 pulgadas 4 chips SATA SSD de 2,5 pulgadas (SW RAID) 4 chips SATA de 2,5 pulgadas y 2 NVMe de 2,5 pulgadas (RAID de software) 4 unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas y 2 NVMe de 2,5 pulgadas (RAID de hardware)	4 x 3,5 pulgadas 8 x 2,5 pulgadas 6 unidades SAS/SATA de 2,5 pulgadas y 2 NVMe de 2,5 pulgadas	8 x 2,5 pulgadas 10 x 2,5 pulgadas 10 x 2,5 pulgadas 14 E3.S 16 E3.S 2 x 2,5 pulgadas (parte posterior) 2 x E3.S (parte posterior)	12 x 3,5 pulgadas 8 x 2,5 pulgadas 16 x 2,5 pulgadas 24 x 2,5 pulgadas 16 E3.S 2 x 2,5" (parte posterior) 4 x 2,5" (parte posterior) 4 x E3.S (parte posterior)	8 x 2,5 pulgadas 16 x 2,5 pulgadas 24 x 2,5 pulgadas 8 E3.S 2 x 2,5 pulgadas (parte posterior)	8 x 2,5 pulgadas 16 x 2,5 pulgadas 24 x 2,5 pulgadas 32 x 2,5 pulgadas 16 E3.S 8 x 2,5 pulgadas + 16 E3.S	4 x 3,5 pulgadas 8 x 2,5 pulgadas 10 x 2,5 pulgadas 2 x 2,5 pulgadas (parte posterior)	12 x 3,5 pulgadas 8 x 3,5 pulgadas 8 x 2,5 pulgadas 16 x 2,5 pulgadas + 8 x NVMe 2 x 2,5 pulgadas (parte posterior)	12 x 3,5" (bahía frontal) + 12 x 3,5" (bahía intermedia) 2 x 2,5" o 4 x 2,5" o 4 x 3,5" o 4 E3.S (parte posterior)	6 x 2,5 pulgadas 8 x 2,5 pulgadas 6 E3.S
Unidades NVMe de hasta:	2	2	10	24	24	24	10	8	4	8
Ranuras PCIe de 5.ª generación hasta:	N/A	2	2	4	8	12	2	2	N/D	12
Ranuras PCIe de 4.ª generación hasta:	2	2	3	8	4	N/D	3	4	5	N/D
Soporte de acelerador hasta:	N/A	1 x 60 W SW	3 x 75 W SW	2 x 350 W DW o 6 x 75 W SW	N/A	4 x 400 W DW	N/A	2 x 75 W SW	2 x 75 W SW, 1 x 75 W SW + 1 x 150 W SW o 1 x 180 W DW	4 DW de 400 W o 12 SW de 75 W
Altura del rack (U)	1	1	1	2	2	4	1	2	2	2
Seguridad integrada	TPM 2.0 FIPS, certificado por CC-TCG, TPM 2.0 China NationZ, firmware firmado criptográficamente, alerta de intrusión en el chasis, seguridad estándar de arranque seguro, raíz de confianza de silicio, bloqueo de sistema (requiere iDRAC9 Enterprise o Datacenter), cifrado de datos en reposo (SED con administración de claves local o externa), verificación de componentes seguros (verificación de integridad de hardware) y borrado del sistema en todos los racks.									

Servidor en rack	R7625	R6625	R7615	R6615
				
Atributos clave	Rendimiento innovador	Rendimiento innovador	Rendimiento y escalabilidad potentes	Rendimiento máximo y excelente TCO
Cargas de trabajo objetivo	Computación de alto rendimiento (HPC), infraestructura de escritorios virtuales (VDI), virtualización	Computación de alto rendimiento (HPC), infraestructura de escritorios virtuales (VDI), virtualización	Almacenamiento definido por software (SDS), virtualización, análisis de datos	Virtualización, infraestructura hiperconvergente (HCI), virtualización de funciones de red (NFV)
Tipo de procesador	2 procesadores AMD EPYC™ serie 9004 de 4.ª generación, hasta 128 núcleos por procesador	2 procesadores AMD EPYC™ serie 9004 de 4.ª generación, hasta 128 núcleos por procesador	Un procesador AMD EPYC™ Serie 9004 de 4.ª generación; hasta 128 núcleos	
Ranuras DIMM DDR5 (capacidad máxima)	24 (6 TB)	24 (6 TB)	12 (3 TB)	
Unidades de disco hasta:	8 x 3,5 pulgadas 12 x 3,5 pulgadas 8 x 2,5 pulgadas 16 x 2,5 pulgadas 24 x 2,5 pulgadas 2 x 2,5" (parte posterior) 4 x 2,5" (parte posterior) 4 x E3.S (parte posterior)	4 x 3,5 pulgadas 8 x 2,5 pulgadas 10 x 2,5 pulgadas 14 E3.S 16 E3.S 2 x 2,5 pulgadas (parte posterior) 2 x E3.S (parte posterior)	8 x 3,5 pulgadas 12 x 3,5 pulgadas 8 x 2,5 pulgadas 16 x 2,5 pulgadas 24 x 2,5 pulgadas 2 x 2,5" (parte posterior) 4 x 2,5" (parte posterior) 4 x E3.S (parte posterior)	4 x 3,5 pulgadas 8 x 2,5 pulgadas 10 x 2,5 pulgadas 14 E3.S 16 E3.S 2 x 2,5 pulgadas (parte posterior) 2 x E3.S (parte posterior)
Unidades NVMe de hasta:	24	10	24	10
Ranuras PCIe de 5.ª generación hasta:	4	2	4	2
Ranuras PCIe de 4.ª generación hasta:	8	3	4	3
Soporte de acelerador hasta:	2 x 300 W DW o 6 x 75 W SW	3 x 75 W SW	3 x 300 W DW o 6 x 75 W SW	3 x 75 W SW
Altura del rack (U)	2	1	2	1
Seguridad integrada	TPM 2.0 FIPS, certificado por CC-TCG, TPM 2.0 China NationZ, firmware firmado criptográficamente, alerta de intrusión en el chasis, seguridad estándar de arranque seguro, raíz de confianza de silicio, bloqueo de sistema (requiere iDRAC9 Enterprise o Datacenter), cifrado de datos en reposo (SED con administración de claves local o externa), verificación de componentes seguros (verificación de integridad de hardware) y borrado del sistema en todos los racks.	TPM 2.0 FIPS, certificación CC-TCG, TPM 2.0 China NationZ, firmware firmado criptográficamente, arranque seguro, borrado seguro, raíz de confianza de silicio, bloqueo de sistema (requiere iDRAC9 Enterprise o Datacenter), AMD Secure Memory Encryption (SME) y virtualización cifrada segura (SEV) de AMD		

Servidor en rack	R450	R550	R650	R750
				
Atributos clave	Valor y enfoque en densidad, TI diseñada para fines generales	Versátil, con optimización de valor, preparado para la virtualización, TI diseñada para fines generales.	Alta escalabilidad, rendimiento de carga de trabajo optimizada	Rendimiento destacado para las cargas de trabajo más exigentes
Cargas de trabajo objetivo	Infraestructura de TI pequeña, máquina virtual ligera, cargas de trabajo específicas para pequeñas empresas	Infraestructura de TI pequeña, densidad de máquina virtual ligera, cargas de trabajo específicas para pequeñas empresas	Estandarización de cargas de trabajo mixtas, base de datos y análisis, HFT, ambientes corporativos tradicionales de TI, VDI, HPC, inteligencia artificial o ML	Bases de datos y análisis, HPC, ambientes corporativos tradicionales de TI, VDI, inteligencia artificial o ML
Tipo de procesador	2 procesadores escalables Intel Xeon de 3.ª generación; hasta 24 núcleos por procesador		2 procesadores escalables Intel Xeon de 3.ª generación; hasta 40 núcleos por procesador	
Ranuras DIMM DDR4 (capacidad máxima)	16 (1 TB)	16 (1 TB)	32 (4 TB)	32 (8 TB)
Unidades de disco hasta:	4 x 3,5 pulgadas 8 x 2,5 pulgadas	8 x 3,5 pulgadas 8 x 2,5 pulgadas 16 x 2,5 pulgadas	4 x 3,5 pulgadas 8 x 2,5 pulgadas 10 x 2,5 pulgadas 2 x 2,5 pulgadas (parte posterior)	12 x 3,5 pulgadas 8 x 2,5 pulgadas 16 x 2,5 pulgadas 24 x 2,5 pulgadas 2 x 2,5 pulgadas o 4 x 2,5 pulgadas (parte posterior)
Unidades NVMe de hasta:	N/A	N/A	12	24
Ranuras PCIe de 4.ª generación hasta:	2	3	3	8
Ranuras PCIe de 3.ª generación hasta:	N/A	1	N/D	N/D
Soporte de acelerador hasta:	N/A	N/A	3 x 75 W SW	2 x 300 W DW o 4 x 150 W SW o 6 x 75 W SW
Altura del rack (U)	1	2	1	2
Seguridad integrada	TPM 1.2/2.0 FIPS, CC-TCG certificada, TPM 2,0 China NationZ, firmware firmado criptográficamente, alerta de intrusión en el chasis y arranque seguro como seguridad estándar en todos los racks. Características de seguridad integrada, como Silicon Root of Trust, Bloqueo del sistema (requiere iDRAC9 Enterprise o Datacenter) y el borrado del sistema en todos los racks			

Sustentabilidad

Desde materiales reciclados en nuestros productos y embalaje hasta opciones cuidadosas e innovadoras para la eficiencia energética, el portafolio de PowerEdge está diseñado para fabricar, entregar y reciclar productos a fin de ayudar a reducir la huella de carbono y reducir los costos operativos. Incluso facilitamos el retiro responsable de los sistemas heredados con Dell Technologies.

Descubra más sobre los servidores PowerEdge

Obtenga más información
Soluciones de Dell Networking

Comuníquese
con un experto de Dell Technologies

Ver más
recursos

Siga en Dell.com

Siga en X

Siga en Linkedin

Comparta su experiencia con #DellTechnologies

Para obtener una lista completa, consulte en www.dell.com/PowerEdge La disponibilidad de los productos puede variar según la región. Comuníquese con sus representantes de Dell para obtener más información.
Copyright © Dell Inc. Todos los derechos reservados. Dell Technologies, Dell y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Dell Inc. o sus subsidiarias. Las demás marcas comerciales pueden ser marcas comerciales de sus respectivos dueños.

Abril de 2026 Rev. A03